FY2026 IR

KH VATEC®

www.khvatec.com

Disclaimer

본 자료는 재무제표 및 향후 전망에 관한 내용을 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

본 자료는 객관적 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부 예상, 전망 또는
주관적 판단에 의한 표현이 포함되어 있을 수 있고, 향후 환경의 변화,
상이한 데이터 집계기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이
도출 될 수도 있음을 인지하시기 바랍니다.

따라서 여기에 포함되어 있는 서술 정보만을 믿고 이 정보에만 의존한
투자결정을 내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다.



Contents

- 2026년 2분기 실적요약
- 회사소개
- 경영환경 및 전망
- 별첨



STAGE 1

2026년 2분기 실적요약

`26년 2분기 실적요약 (연결 재무제표 기준)

`26년 2분기 매출액은 1,039억으로 전분기 대비 88.6% 영업이익은 50억으로 196% 증가함

(단위: 억원)

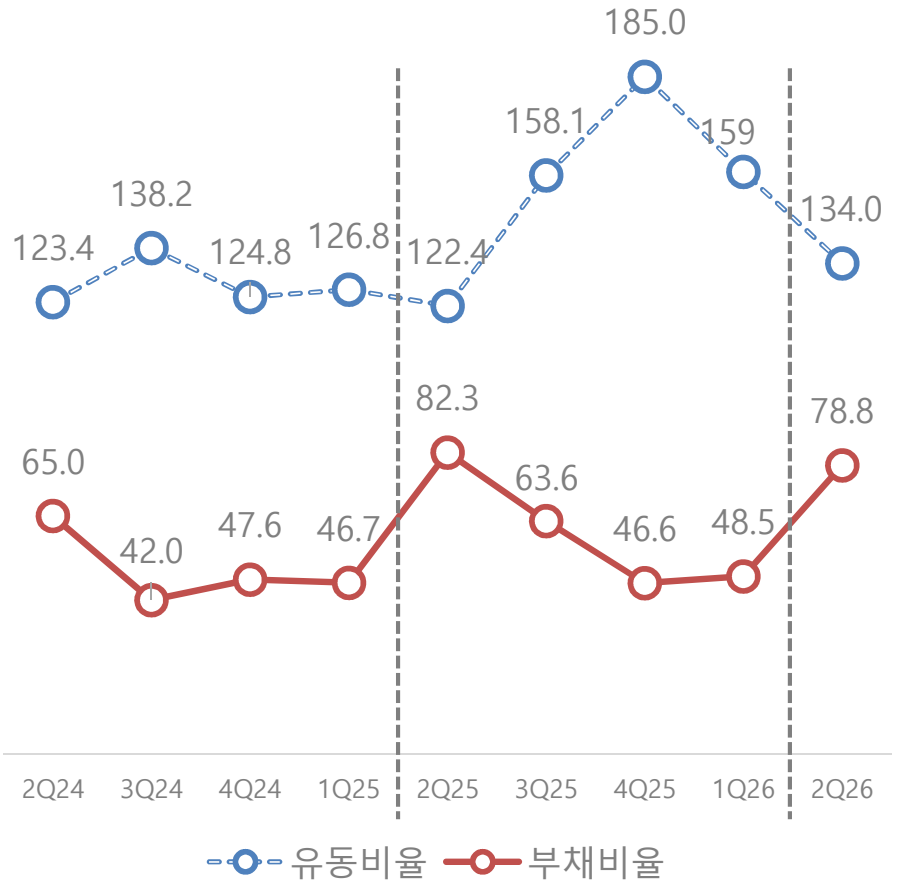
구분	2025년 2Q	2026년 1Q	2026년 2Q	증감률	
				YoY	QoQ
매출액	1,365	551	1,039	-23.9%	88.6%
조립모듈(힌지)	901	133	695	-22.9%	422.6%
자동차부품	63	53	70	11.1%	32.1%
기타(로봇, 통신장비, ATM, IDC 등)	401	365	274	-31.7%	-24.9%
매출원가	1,178	471	922	-21.8%	95.7%
매출총이익	187	80	117	-37.4%	46.8%
판관비	71	63	68	-5.5%	7.1%
영업이익	116	17	50	-57.1%	195.7%
영업이익률	*8.5%*	*3.1%*	*4.8%*	*-3.7%p*	*1.7%p*
EBITDA	173	72	59	34.1%	81.7%
EBITDA이익률	*12.7%*	*13.1%*	*5.7%*	*-7.0%p*	*-7.4%p*
당기순이익	20	3	31	51.0%	957.0%
당기순이익률	*1.5%*	*0.5%*	*3.0%*	*1.5%p*	*2.4%p*

`26년 2분기 실적요약 (연결 재무제표 기준)

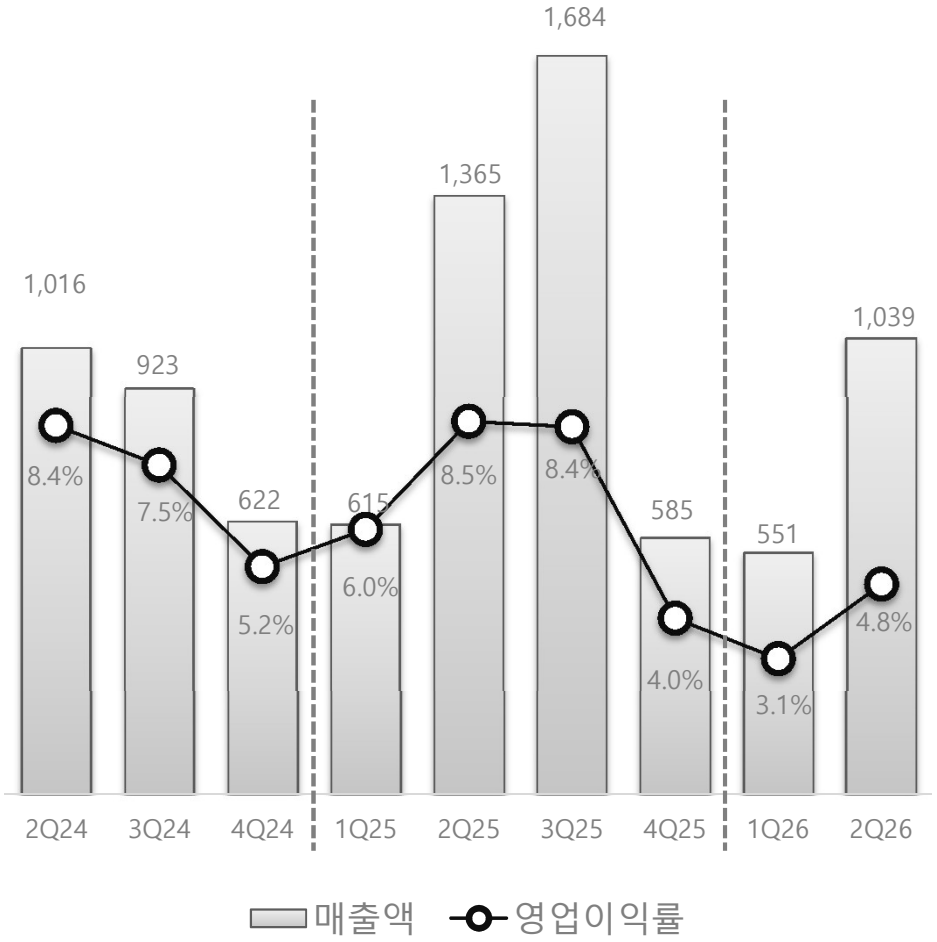
`26년 2분기 기준 유동비율 134.0%, 부채비율 78.8%로 안정적으로 유지되고 있음

주요 재무비율

(단위 : %)



분기별 매출액 / 영업이익률 추이

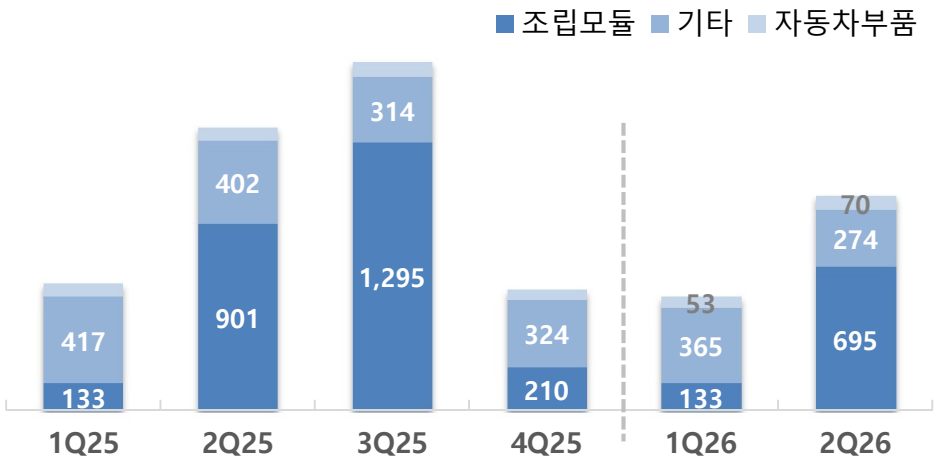


`26년 2분기 실적요약 (연결 재무제표 기준)

Ti-IDC의 매출이 감소하였으나, 신규사업(로봇, 통신, ATM등) 매출 증가로 분기 매출 감소폭 만회

분기별 매출구성

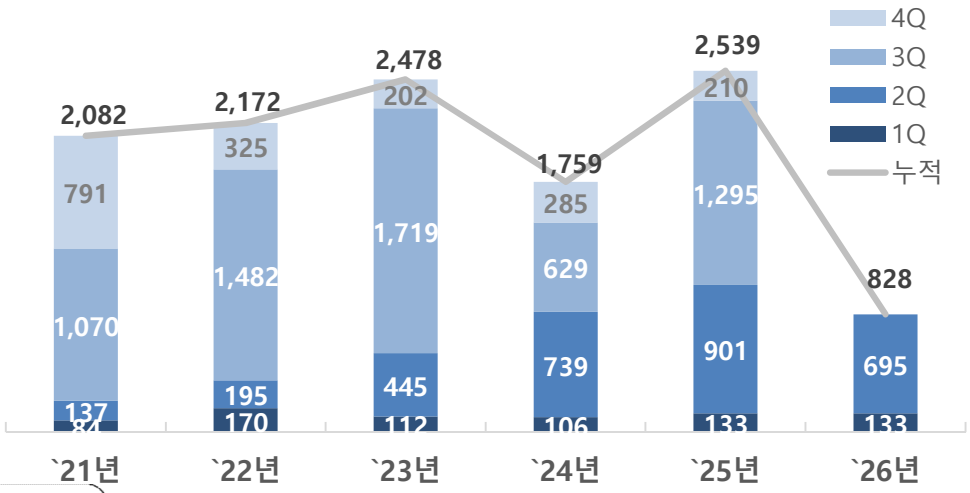
(단위 : 억원)



※`25년부터 기타 항목에서 자동차 부품을 분리하여 작성

연도별 조립모듈 매출추이

(단위 : 억원)



주요 사업현황 및 전망

① 조립모듈

- **`26년 폴더블폰 라인업 추가** (와이드폴드)
- `26년 북미 A사 폴더블폰 출시 예정에 따른 시장확대 기대
- 고객사 다변화 지속 추진(C-brand 확장 계획)
- 전년 대비 폴더블폰 출시 지연으로 일부매출 3Q 순연

② 메탈케이스 및 기타

- `26년 1분기 Ti-IDC 감소에 따른 매출 하락
- 신규사업 지속 매출 증대 (로봇, 통신장비, ATM 등)

③ 자동차 부품

- `25년부터 사업영역 본격화
- `26년 칵소몰딩 디스플레이 브라켓의 매출기여 반영 예정
- 무빙메커니즘 추가 수주 체결 및 고객사 다변화 추진
- 인도법인, 비스테온 공급업체 등록 (칵소몰딩)



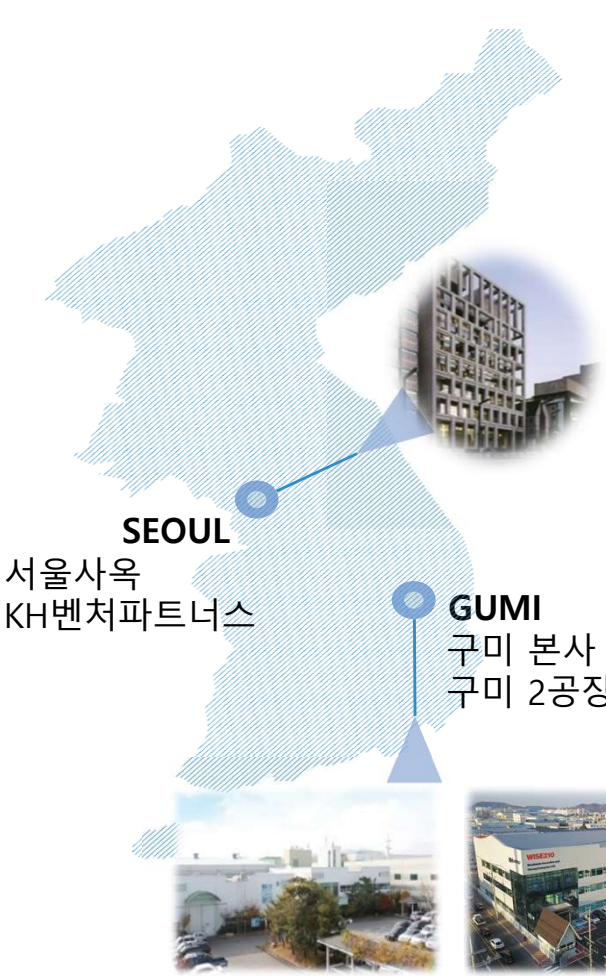
STAGE 2

회사소개

1. 주요사업장

1) 국가별

KH바텍은 국내에는 서울사무소와 구미 본사 및 1,2공장을 운영 중에 있으며 해외로는 중국, 베트남, 인도에 해외법인을 운영하고 있음





※ VC : Vehicle Component (자동차부품)

1. 주요사업장

2) 지역별

KH바텍은 국내에는 구미본사(`25년 VC 공장 확장)와 서울사무소를 운영 중에 있으며 해외로는 중국(혜주), 베트남 (타이응웬, 하노이-박닌), 인도(그레이터 노이다)에 해외법인을 운영하고 있으며, 타이응웬 지역에 신규 건설한 VC전용공장을 `25년 4월부터 가동함

('26년 3월말 기준)



한국 (서울, 구미)

설립일 : 1992년11월
직원수 : 200명
대지 : 5,700평
건평 : 3,735평



KHV 타이응웬

설립일 : 2023년 4월
직원수 : 1,103명
대지 : 37,000평
건평 : 16,000평



KHV 하노이 (박닌 포함)

설립일 : 2018년 1월
직원수 : 2,079명
대지 : 15,000평
건평 : 11,450평



KHV 혜주

설립일 : 2010년 6월
직원수 : 76명
대지 : 24,000평
건평 : 20,000평



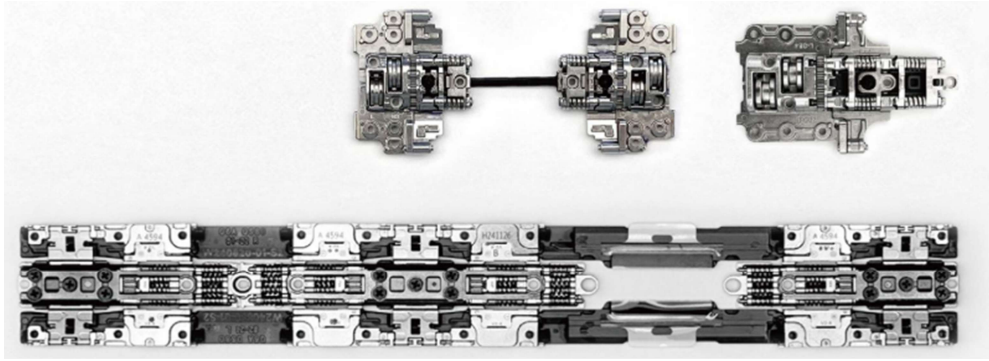
KHV 인도

설립일 : 2019년 3월
직원수 : 1,683명
대지 : 23,000평
건평 : 6,500평

KH바텍은 지속성장하는 폴더블 스마트폰의 핵심부품인 힌지를 생산하고 있으며, 메탈케이스 제품은 이미 세계 최고의 수준으로 인정받고 있음

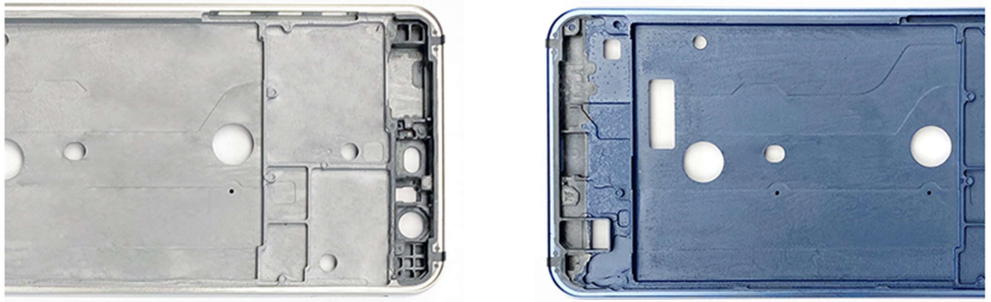
Foldable Hinges

KH바텍은 독보적인 힌지 설계 능력, 금속분말 사출성형(MIM) 기술, 조립기술을 바탕으로 폴더블 힌지를 생산하고 있음.
폴더블 힌지란, 폴더블 OLED를 기반으로 한 폴더블 폰의 화면을 접었다 펼 때의 패널이 맞닿는 충격을 최소화시켜 구동을 가능케 하며, 새로운 폼팩터 시대에 맞춰 폴더블 뿐만 아니라, Rollable, Slidable 등 다양하게 적용될 스마트폰의 핵심 부품임.



IDC (Insert Die-Casting)

금속 블록을 통째로 가공하는 공법을 탈피하여, 외장면은 알루미늄 압출재, 스테인리스, 티타늄 등의 합금을 적용하여 아노다이징, 증착 등의 기술로 외장면을 처리하고, 내장면은 알루미늄 다이캐스팅을 구현하여 블록을 통째로 가공하는 방식대비 절삭 가공 시간을 획기적으로 줄인 KH바텍만의 독보적인 기술.



VAW(Value Added Welding)

당사가 자체 개발한 VAW(Value Added Welding) 기술은 Die-Casting 내장품과 알루미늄 외관용 케이스를 접합하는 기술로써 당사의 고유한 특허 기술임. VAW기술을 활용할 경우 생산비용과 생산시간을 크게 단축 시킬 수 있어 국내외 고객들로부터 저가형 알루미늄 케이스용 최상의 기술로 인정받고 있음.



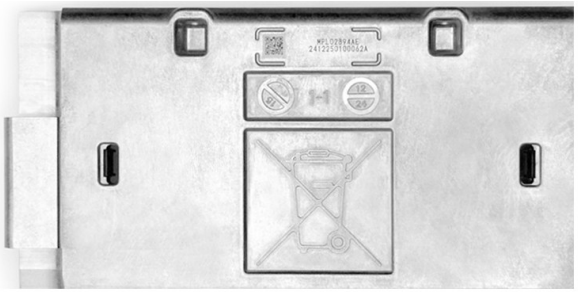
2. 주요제품

KH바텍의 전기자동차용 End Plate 및 전장품을 개발~제조를 하고 있으며, 로봇 및 열전달과 전자파차폐가 탁월한 네트워크 제품들로 사업모델이 확장되고 있음

배터리 (End Plate)

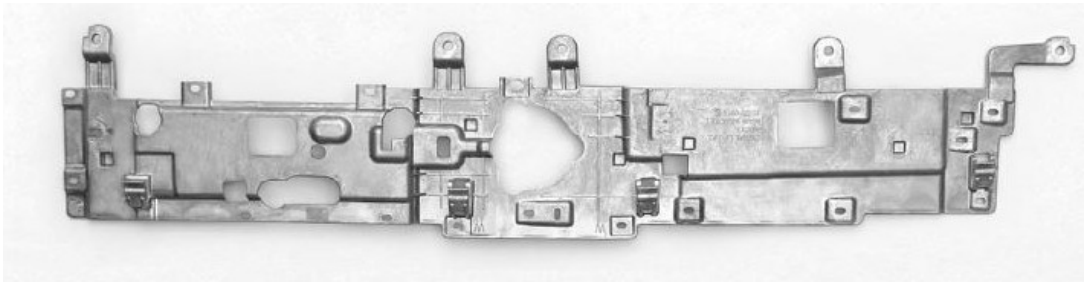
배터리 CELL을 내·외충격으로부터 보호하는 핵심 부품인 End Plate를 고진공 Die-Casting, Insert Die-Casting 기술로 자체개발하여 생산 중에 있음.





Display Bracket & 기타

차량용 디스플레이 브라켓을 알루미늄 및 마그네슘으로 생산하고 있으며, 특히 마그네슘 제품은 칙소몰딩 공법을 활용하여 가볍고 친환경적임.
또한 소자의 열을 흡수하여 외부로 방출하는 알루미늄 HEAT SINK 및 DRL, RCL의 브라켓 부품을 생산하고 있음.



ROBOT

KH바텍은 연평균 성장률이 30% 이상으로 예상되는 로봇산업 분야에 필요한 초정밀 기구물 개발에도 박차를 가하고 있음.
미래 산업현장에 필수적인 협동로봇의 부품을 필두로 하여 견고하면서도 가벼운 그리고 고신뢰성에 특화제품 분야로 진출하고 있음.
또한 로봇 구동의 핵심인 감속기를 비롯한 구동부품 분야까지 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

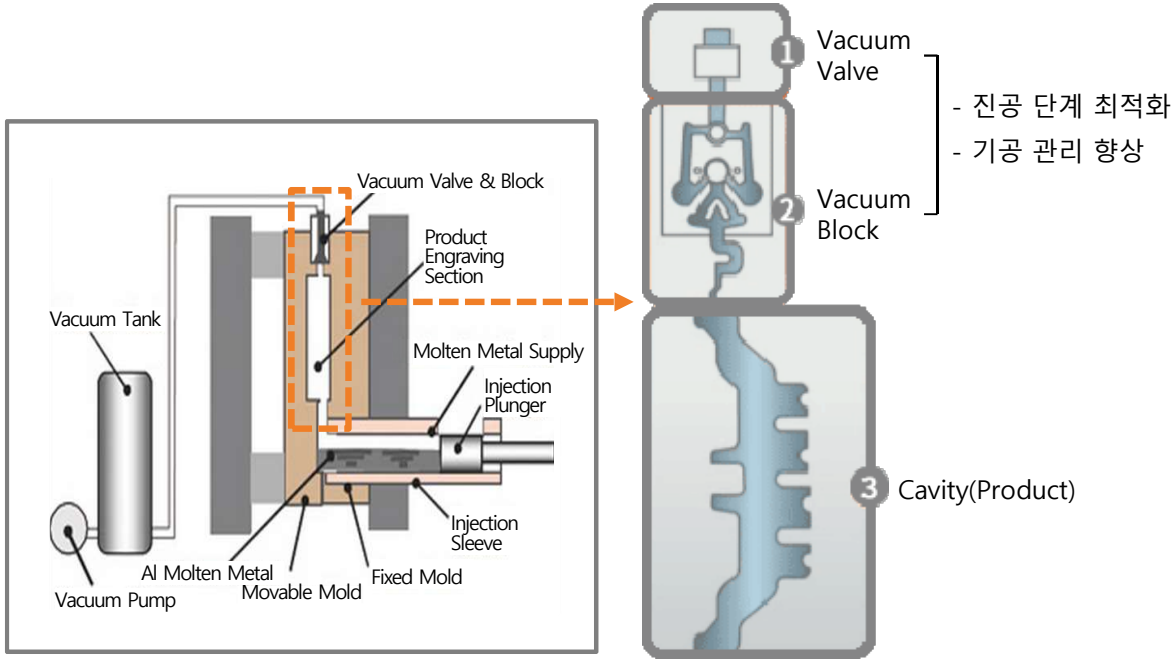




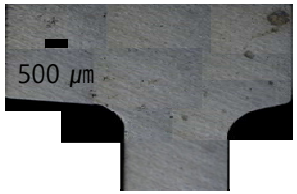
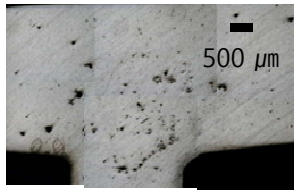
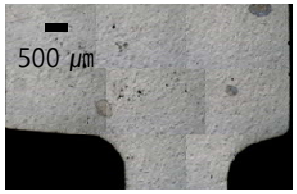
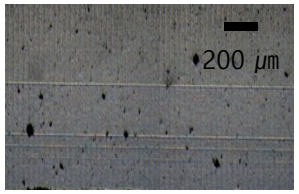
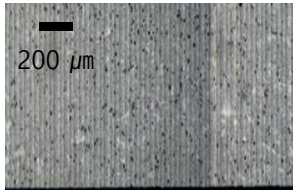


진공 다이캐스팅

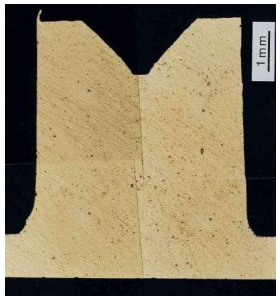
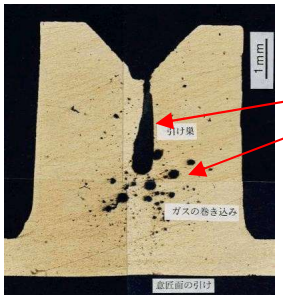
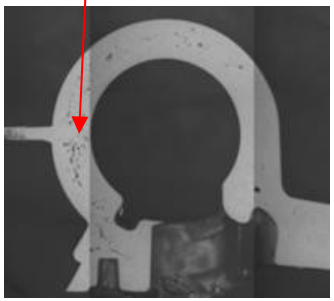
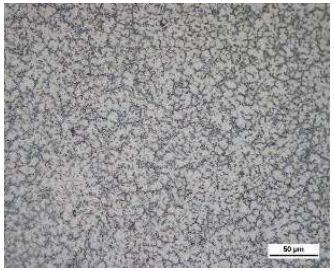
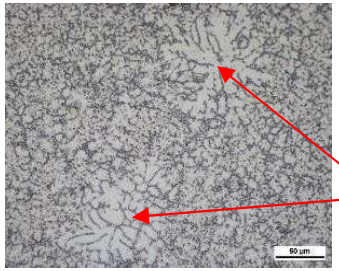
① 용융 금속 사출 전 진공선행
② 다이캐스팅 과정 내 기공 감소 관리
③ 윤활유 및 연소에 의한 오염 최소화



일반 다이캐스팅 vs 진공 다이캐스팅

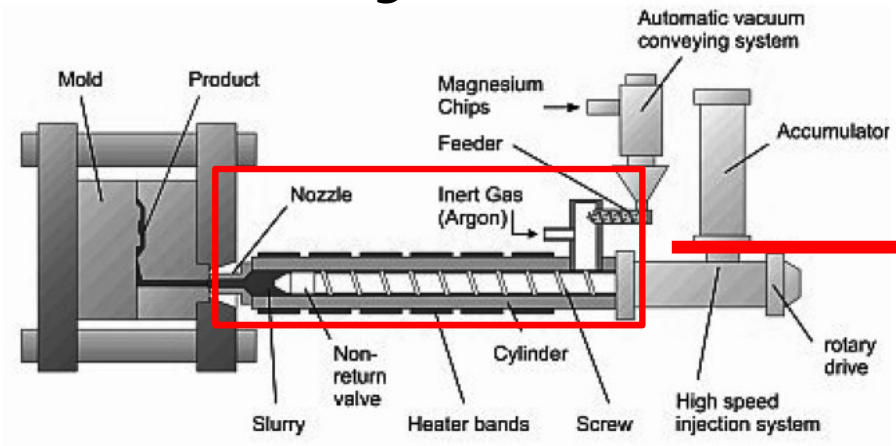
구분	일반	진공
Gate		
Vent		
	일반 D/C 대비 내부기공이 현저하게 감소	
Dia-Cut		
	일반 D/C의 기공 크기가 50~70μm인데 반하여 기공 크기가 20μm 이상 더 작음	

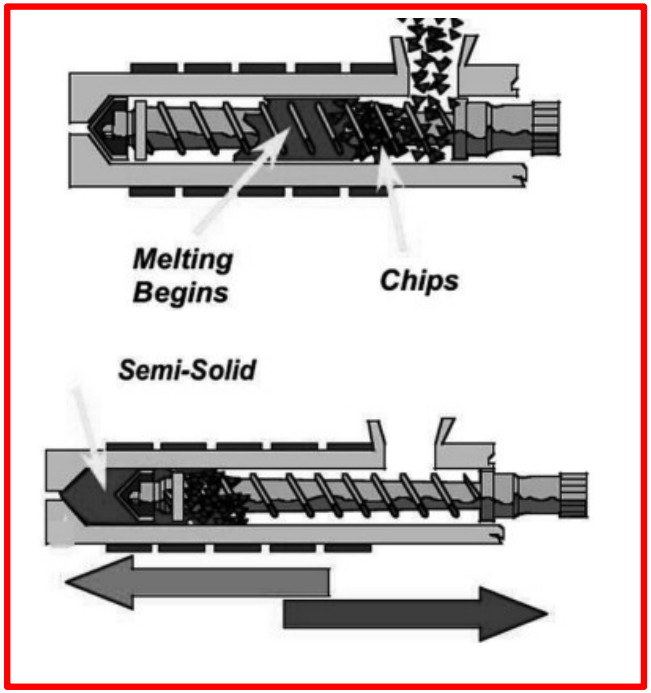
D/C : Die-Casting(다이캐스팅)

구분	Thixomolding (칙소몰딩)	Cold chamber
용융방식	가열 실린더 + 스크류	용해로 (용탕과 사출부가 분리)
용해온도	585~670℃	640~670℃
보호가스	Ar (아르곤가스)	SF6 (육불화황)
재료형태	Mg chip	잉곳
사출압력 (Mpa)	62~103	400~800 (고압)
특징	* 반용융 상태로 금형의 열충격 적음 → 금형수명 ↑ * 제품내부 조직이 치밀하고 미세기공이 현저히 적음 * 친환경 생산방식 : 전기료 ↓, 환경문제 유발하는 SF6無 * 고가의 칩형태 재료 필요 및 스크류 마모 심함	* 주조 압력을 높일 수 있어 두꺼운 중대형 부품 제조 가능 * 소모품이 저렴하고 교체가 간편 * 특정 소재에 종속되지 않고, 대량생산 적합
노트북 케이스 Screw Boss 단면 [광학 현미경]	 낮은 온도 (580~600 ℃)로 사출시 가스 기공 결함감소	 높은온도 (650 ℃)로 사출시 응고수축으로 인한 가스기공 다수 발생
휴대폰 Hinge 단면 [X-Ray]		
Micro 조직 [광학 현미경]	 결정립이 치밀하고 규칙적	 결정립이 굵고 불규칙

※ 2011.10월 한국마그네슘기술연구조합 자료 인용

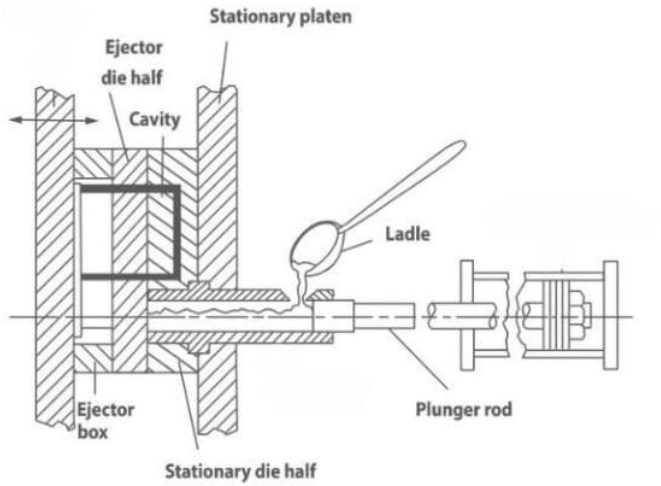
Thixomolding





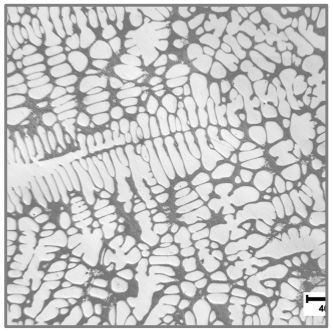
Cold chamber

(기존 KH바텍 설비)



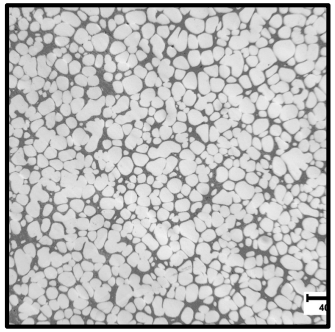
깎아 만들던 것을, 부어 만든다

일반 주조 · 수지상 조직



나뭇가지처럼 얽힌 조직
→ 틈에 기공·균열

반응고 · 구상 조직



둥근 알갱이가 촘촘히
→ 결함 최소화

금속을 완전히 녹이지 않고 슬러시(반고체) 상태로 밀어 넣는다

1) 조직이 치밀 → 열처리 · 아노다이징 가능
2) 결함 감소 → 강도 · 기밀성 확보 (기공대폭축소)
3) 낮은 성형 온도(약 600℃) → 금형 수명 · 사이클타임 개선
4) 전신재(6063 · 7075) 성형 가능 → **Main 절삭 공정(Full CNC) 대체**

[비교 기준 ① 현행 "압출 + CNC 절삭" 대비]

30%
제조원가 절감
절삭 가공량 대폭 감소 (Full CNC대체)

[비교 기준 ② 일반 다이캐스팅 대비 (동일 제품 · 동일 금형)]

3~4배
금형 수명 연장 (7만 → 21만)
히트크랙 2,000 → 8,000 Shot

25%
사이클타임 단축
680℃ → 600℃ 저온 성형

적용 시장 AI 데이터센터 서버 부품 + 휴머노이드 로봇 외골격 · 감속기 + 자동차 전장 · 섀시 부품 → **무기공(Zero-Porosity) 요구제품**

반응고 성형(Semi-Solid Metal Forming, SSM) 사업화 - 마그네슘으로 시작해 알루미늄으로 확장

STEP 1 마그네슘 칙소몰딩
2026년 첫 모델 양산 진입

→

STEP 2 알루미늄 반응고 다이캐스팅
R&D 진행중

· 2014~2017년 알루미늄 반응고 선행 R&D 수행
· 한국 · 중국 · 베트남 · 인도 4개국 생산기지
(비중국 공급 대응 가능)



STAGE 3

경영환경 및 전망

1. KHV 미래 5대 Biz

KHV은 중기 비전으로 WISE210을 선포하여 실행중에 있으며, 이를 위하여 5대 미래 사업 영역을 설정하고, 투자 및 기술개발을 가속화 하고 있음

KHV 5대 Biz



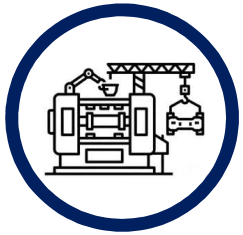
① AIDC / 반도체 패키징 *(급성장 산업 공략)*

- 반도체등 기기 성능 증대로 고방열 기구물 니즈 급증
- AIDC : Manifold, Connector 등 5종
- 반도체 패키징 금속 부품



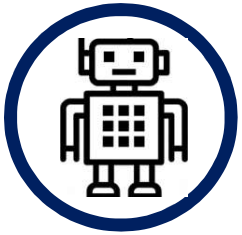
② 롤러블 디지털 콕핏 *(세계 최초, 자율주행 수혜)*

- 글로벌 디지털 콕핏 주요 메이커대상 (잠재고객)
- 독보적 설계 + 제조기술로 독점적 지위 유지
  - Al D/C, 칙소몰딩(Mg), 도장, 아노다이징, CNC, Press, 압출



③ 칙소몰딩 (Thixomolding)

- 경량화 및 친환경 트렌드로 고객의 Mg 니즈 증대
- 타이응웬 법인 대규모 인프라 구축 완료
- 고객의 탈중국 수혜, 높은 수익성 확보



④ Robot (종합 *Metal* 집합체)

- 협동로봇, 4족보행, 휴머노이드 Metal, EMS
- 감속기 / 감속기 Metal
  - 지분투자 회사인 이스턴기어와의 감속기(웜기어) 개발 협업
  - 자체 감속기 개발완료 (Wolfrom, 이중 링기어 복합유성기어)
- 다이캐스팅 + 아노다이징, 다축가공 공법 개발



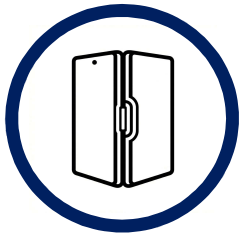
⑤ 고신뢰성 금속 *(무기공, 고내구성, 고정밀도)*

- 반응고 성형을 통한 무기공(Zero-Porosity) 구현
- 내열, 내식, 정밀성 요구로 단가 및 진입장벽 상승
- 타겟제품 : 의료기기, 통신, 반도체 등

2. 최근 업계 동향 (기존사업)

최근 스마트폰 업계는 폴더블 스마트폰의 성장 및 북미 A사 스마트폰의 Ti 채용 확대가 기대 중이며 전장시장의 성장 역시 기대감이 커짐에 따라 KH바텍은 이에 맞는 솔루션을 적용 하고자 함

업계 기술 / 트렌드



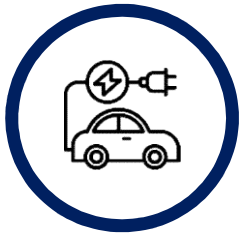
① 폴더블 스마트폰

- 국내 고객사의 폴더블폰은 `19년 이래로 `24년 첫 역성장이 있었으나 중화권 업체들의 경쟁적인 신규제품 출시 및 북미 "A"사의 폴더블폰 기대
- `26년 약 23백만대, `27년 약 34백만대로 성장 전망 **(하나, 대신증권 추정)**
- **폴더블 폼펙터의 확대** (WIDE, 노트북)



② 메탈케이스의 확대

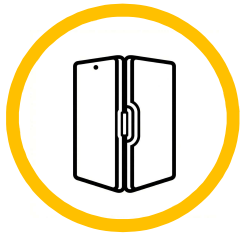
- **북미 A사 Ti 채용 영향**
  - Bar타입 채택 확대 및 폴더블폰 확대 적용 기대
- 갤럭시 A시리즈 메탈케이스 채택 (A5) → A3확대 기대



③ 기타 전장부품

- EV 시장 대비 ESS 시장 성장 본격화 (LG에너지솔루션 기준 `26년 예상매출 EV 10.2조원, ESS 12.1조원, 미래에셋증권 추정)
- 국내 주요 전장업체의 수주잔고 우상향 및 `26년부터 본격 매출반영
- 전장부품 시장이 `25년부터 스마트폰 부품 시장 추월 예상

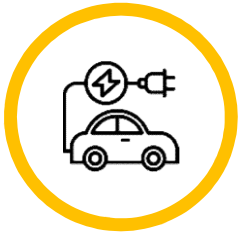
KHVATEC Solution



Foldable Hinge



Insert Die-Casting (IDC)
Value Added Welding (VAW)



Display Bracket / End Plate

3. ESG 경영 강화

ESG 경영의 중요성이 꾸준히 증가함에 따라, `21년 KH바텍도 ESG 경영 도입을 선포하고 탄소배출감소, 지역사회 기여, 지배구조 개선 등 ESG 경영을 가속화 중임



KHV ESG 경영 강화

- ESG란? 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 등 투명경영을 고려해야 지속가능한 발전이 가능하다는 철학
- KH바텍은 `21년 본격적인 ESG 경영철학을 도입하기 시작
- `26년에도 ESG경영은 더욱 중요한 키워드가 될 것으로 전망됨에 따라 KH바텍은 꾸준히 ESG 경영을 강화할 예정

KH바텍의 ESG 주요활동

- `23~`24년 **한국ESG 기준원 ESG 평가등급 A**
- `24~`25년 **서스틴베스트 A등급, CDP B등급**
- `24년~`25년 **CDP SEA 평가 A- 등급** (공급망 참여평가)
- 주주가치 제고를 위한 현금배당 결정 **(`25년 배당성향 39%)**
  - `24~`25년 분기배당 시행 / `25년 배당 분리과세 정책 적용
- KHV-ESG 환경부문 주요 목표 설정 및 실적 공개 (자사 홈페이지)
- `24년 태양광 발전(구미 2공장)으로 탄소중립에 기여
- 한국 및 해외법인 지역사랑 나눔행사 참석 / 물품 후원

`26년 KH바텍 ESG 주요 목표

구분	내용
종합목표	**서스틴베스트, CDP A등급 달성**
E (환경)	▪ 온실가스 배출 감소 / 재생에너지(전력) 사용 ▪ **태양광 발전 확대** (구미 1공장) ▪ **Scope 3 배출량 개선** (국내 법인부터 순차적 개선)
S (사회)	▪ 중대재해처벌법 도입에 따른 공장 내 안전관리 강화 ▪ 지역사회 기여 (문화예술나눔, 불우이웃돕기등)
G (지배구조)	▪ 이사회 운영 강화 및 주주와의 소통 강화 ▪ **기업가치제고계획(밸류업) 공시 도입**



STAGE 4

별첨

별첨1. 3개년 연결 재무제표

손익계산서

(단위: 억원)

	2023	2024	2025
매출액	3,636	3,110	4,249
매출원가	2,905	2,606	3,635
매출총이익	731	504	614
판관비	395	286	296
영업이익	336	219	318
기타수익	233	150	53
기타비용	125	76	166
금융수익	54	13	11
금융비용	56	32	42
당기순이익	309	213	204

재무상태표

(단위: 억원)

	2023	2024	2025
유동자산	1,334	1,501	1,570
매각예정자산	72	69	69
비유동자산	2,019	2,300	2,402
자산 총계	3,425	3,871	4,042
유동부채	939	1,203	849
매각예정부채	-	-	-
비유동부채	16	45	436
부채총계	955	1,248	1,285
자본금	118	118	118
자본잉여금	634	634	634
기타자본구성요소	-185	-123	-123
이익잉여금	1,915	2,007	2,139
자본총계	2,470	2,624	2,757


KH VATEC®